

厦门市集成电路产业发展工作领导小组办公室文件

厦集成电路办〔2022〕1号

厦门市集成电路产业发展工作领导小组办公室 关于印发厦门市进一步加快推进集成电路 产业发展若干措施实施细则的通知

各成员单位，各有关企业：

《厦门市进一步加快推进集成电路产业发展的若干措施实施细则》已经市政府研究同意，现印发给你们，请认真组织实施。

厦门市集成电路产业发展工作领导小组办公室



（此件主动公开）

厦门市进一步加快推进集成电路产业发展 若干措施实施细则

根据《厦门市人民政府关于印发进一步加快推进集成电路产业发展若干措施的通知》（厦府规〔2022〕11号），制定本实施细则。

一、政策适用范围及申报主体

适用于本市行政区域内具有独立法人资格，符合国家产业发展方向，具有5人以上稳定技术团队（在本市签订劳动合同、缴交社保），有一定数量知识产权和固定研发生产经营场所，项目在本市实施，且经厦门市集成电路产业发展工作领导小组办公室（以下简称“市集成电路办”）确认，专门从事集成电路领域（包括EDA工具、逻辑电路、存储器、特色工艺半导体、化合物半导体、微机电系统与智能传感器、基础电子元器件、Mini/Micro LED、OLED、激光显示等）设计、制造、封装测试、装备与材料等研发、生产、公共服务的单位。

二、申报条件和材料

第一类 支持人才引进

（一）高端人才安家补助

1. 申报条件：

（1）市集成电路办发布项目申报通知当年和前2个年度内新引进的。

(2) 经市集成电路办审核确认符合《厦门市集成电路产业高端人才评定标准(试行)》。

2. 补助标准:

A类、B类、C类集成电路高端人才, 分别给予100万元、50万元、30万元补助, 按40%、30%、30%的比例分3年发放。

3. 申报材料:

(1) 厦门市集成电路产业高端人才申报书。

(2) 集成电路高端人才安家补助资金汇总表。

(3) 身份证(境外人员提供护照、台胞证等有效身份证件)、学位证书、劳动合同复印件; 个人社保缴费情况证明、个人所得税明细申报情况清单。国(境)外人才须提供合法的入境证明和出入境记录。

(4) 符合《厦门市集成电路产业高端人才评定标准(试行)》相应人才类别(A、B、C类)资格条件的相关证明材料。包括但不限于获得其他单位人才认定文件复印件; 专业技术职务资格证书、聘书复印件; 所获奖项、荣誉、职称、专利、论文等。外文材料需提供翻译件。

(5) 半导体公司排名须参照国际级研究机构IC Insights、Trendforce、Gartner、IDC或IHS、中国半导体行业协会、台湾半导体产业协会发布的最新年度企业排名, 证明材料需提供网络截图及链接, 注明企业排名次序。

(6) 集成电路重点企业年度销售额以企业所得税汇算清缴

报告为准。

4. 备注：市集成电路办采取竞争性专家评审方式组织认定，认定后直接兑现补助。

（二）毕业生就业补助

1. 申报条件：

（1）具有全日制本科以上学历、专业符合《厦门市集成电路产业相关紧缺专业目录》。

（2）毕业后3年内到本市集成电路领域企业就业，“毕业后3年内”指在市集成电路办发布项目申报通知当年的前3个年度内毕业。

（3）与本市集成电路企业签订2年以上的劳动合同。

（4）申报时仍在职。

2. 补助标准：

各类毕业生来本市集成电路企业就业补助标准如下：

本科生18000元/年、硕士生30000元/年、博士生42000元/年给予补助，以实际缴纳社会保险金月数核算补助金额，每名毕业生补助不超过2年。

3. 申报材料：

（1）毕业生就业补助资金汇总表。

（2）①首次申请人员身份证（境外人员提供护照、台胞证等有效身份证件）、毕业证书、学位证书、劳动合同复印件，个人社保缴费情况记录；②非首次申请人员仅需提供个人社保缴费

情况记录。如果学历发生变动还需补充毕业证书、学位证书复印件；如果单位发生变动还需补充劳动合同复印件。

4. 备注：已按原集成电路政策标准享受“毕业生生活补助”且未满2年的，可按新政策补助标准继续享受剩余年限补助，已享受过的部分不再补差。

第二类 支持研发创新

（三）流片补助

1. 申报条件：

完成多项目晶圆流片或首次完成全掩膜工程产品流片的集成电路设计企业、高校或科研院所。

2. 补助标准：

（1）用于研发的多项目晶圆流片补助。①集成电路企业按照直接流片费用的60%给予补助；②高校或科研院所按照直接流片费用的70%给予补助。

（2）首次完成全掩膜工程产品流片补助。集成电路设计企业完成的全掩膜工程产品，按照产品首次流片（含Foundry IP授权、掩膜版制作、晶圆片等，晶圆片数量超过12片的，按12片核算）费用的30%给予补助。

（3）利用符合条件的集成电路生产线首次完成全掩膜工程产品流片补助。集成电路设计企业完成的全掩膜工程产品，按照产品首次流片（含Foundry IP授权、掩膜版制作、晶圆片等，晶圆片数量超过12片的，按12片核算）费用的40%给予补助。

上述补助每个单位年度补助总额最高不超过500万元。

3. 申报材料:

(1) 流片补助资金申请表。

(2) 流片补助资金汇总表。

(3) 项目研发说明(包括产品类型、产品概述、产品技术先进性、产品经济效益)等。

(4) 芯片版图缩略图(需用彩印)、产品外观照片。

(5) 晶圆厂流片项目订单或合同、发票、付款凭证(境外加工的需提供报关单或委外加工证明)、EDA正版软件使用证明;流片项目应包含光罩(层)、晶圆(张),单据金额和申报金额如果有不一致需做说明。

(6) 多项目晶圆项目需要提供以下说明之一:晶圆厂主导的多项目晶圆项目,应在合同上体现;企业自主多项目晶圆项目,需提供图示说明此套光罩所包含的项目;企业采用多合一复合板,需提供多合一板图示说明。

4. 备注:通过第三方流片的,需提供第三方与晶圆厂的代理关系佐证材料。

(四) IP购买补助

1. 申报条件:

(1) 本市从事集成电路设计的企业,购买IP用于集成电路线宽小于0.25微米(含)等高端芯片研发,购买IP后需向市集成电路办报备。

(2) 提供方应为专业IP提供商或设计机构，且成立三年以上。

(3) 购买方与提供方应为非关联关系，且已签订转让或授权合同，完成合同付款，完成多项目晶圆或工程流片。

2. 补助标准:

对符合条件的企业按照IP购买直接费用的30%给予补助，每个单位每年补助总额最高不超过200万元。

3. 申报材料:

(1) IP购买补助资金申请表。

(2) IP购买补助资金汇总表。

(3) IP核使用情况说明、IP使用原理图以及模块图、产品版图(附IP位置标注)，企业购买的IP核实施转化运作的佐证材料(完成多项目晶圆或工程流片，包括但不限于：流片、验证报告等)。

(4) IP转让或授权许可合同、发票及银行支付凭证等。

(5) 合同双方的非关联声明或相关佐证材料。

4. 备注:

(1) IP购买包括授权、转让等形式。

(2) 本条款IP特指因芯片研发需要而进行的IP核复用，包括软核IP、固核IP、硬核IP等，不包含专利、软件著作权等。

(3) 外文材料需提供翻译文本。

(五) EDA工具购买补助

1. 申报条件:

购买的工具应是本企业使用的EDA工具。

2. 补助标准:

(1) 对集成电路设计企业购买EDA工具软件的,按照实际发生费用的20%给予补助。

(2) 对集成电路设计企业购买国产EDA工具软件的,按照实际发生费用的30%给予补助。

(3) 每个单位年度补助总额最高不超过300万元。

3. 申报材料:

(1) EDA工具购买补助资金汇总表。

(2) 购买EDA工具必要性说明(包括购买的模块、版本、功能等基本信息,供应商行业地位概述,工具优势说明)。

(3) 购买合同、发票及银行支付凭证等。

4. 备注: 外文材料需提供翻译件。

第三类 支持提质增效

(六) 设备购买补助

1. 申报条件:

(1) 本市集成电路设计、制造、封测及装备和材料企业,申请的设备须在厦门本地,且已投入使用。

(2) 购买的设备须为光刻设备、薄膜设备、刻蚀清洗设备、离子注入及扩散设备、研磨抛光设备、封装测试设备、检测设备等核心设备。

2. 补助标准:

(1) 对于购买国外厂商配套的核心设备, 按采购金额的5%给予补助。

(2) 对于购买国内厂商配套的核心设备, 按采购金额的10%给予补助。

每个单位年度补助总额最高不超过1000万元。

3. 申报材料:

(1) 设备购买补助资金汇总表。

(2) 项目合同、发票及银行支付凭证复印件(境外购置设备的需提供进口报关单)。

4. 备注: 补助额度以已付款票据(不含税)为准。购置国内设备以增值税专用发票时间为准; 购置进口设备以海关报税单申报日期为准。

(七) 设备融资租赁补助

1. 申报条件:

(1) 本市集成电路设计、制造、封测及装备和材料企业, 通过设备融资租赁方式开展项目建设, 申请的设备须在厦门本地, 且已投入使用。

(2) 申请的设备须为光刻设备、薄膜设备、刻蚀清洗设备、离子注入及扩散设备、研磨抛光设备、封装测试设备、检测设备核心设备。

2. 补助标准:

按照设备融资租赁费用（手续费、利息）的20%给予补助，每个单位年度补助总额最高不超过500万元。

3. 申报材料：

（1）设备融资租赁补助资金汇总表。

（2）项目合同、证明融资租赁手续费、利息费用的发票及银行支付凭证复印件。

（3）融资租赁企业设备采购合同、发票等相关凭证。

（八）电力稳压系统补助

1. 申报条件：

（1）本市集成电路制造、封装测试企业，申请的电力稳压设备须在厦门本地，且已投入使用。

（2）项目电压等级达到10kV（含）以上，稳压设备符合《电力稳压系统设备清单》。

2. 补助标准：

实际设备投资额的20%的补助，每个单位年度补助总额最高不超过500万元。

3. 申报材料：

（1）电力稳压系统补助资金汇总表。

（2）项目电压等级的相关佐证材料。

（3）项目合同、发票及银行支付凭证复印件（境外购置设备的需提供进口报关单）。

（九）洁净室装修补助

1. 申报条件:

(1) 补助对象为本市集成电路设计、制造、封测及装备和材料企业, 洁净室已投入使用。

(2) 洁净室等级须达到千级及以上。

2. 补助标准:

洁净室装修实际造价的20%给予补助, 每个单位年度补助总额最高不超过500万元。

3. 申报材料:

(1) 洁净室装修补助项目汇总表。

(2) 洁净室等级的相关佐证材料。

(3) 项目合同、发票及银行支付凭证复印件。

第四类 支持生态建设

(十) 芯片采购补助

1. 申报条件:

(1) 年销售额1亿元以上的系统(整机、终端、模组)企业。

(2) 企业采购符合条件的集成电路企业设计、生产的芯片, 且用于本市工厂产品的生产制造。

(3) 向关联企业的采购不计入补助核算采购费用总额。

2. 补助标准:

按采购额的10%给予补助, 每个单位年度补助总额最高不超过100万元, 补助期限累计不超过3年。

3. 申报材料:

(1) 芯片采购补助资金汇总表。

(2) 专项审计报告（内容须包含但不限于年度主要产品销售收入，采购项目情况等）；企业年度销售额以企业所得税汇算清缴报告为准。

(3) 芯片应用在整机、终端、模组上的相关佐证材料。

(4) 采购合同、发票及银行支付凭证等。

(5) 双方签章的非关联声明或相关佐证材料。

(十一) 封装测试补助

1. 申报条件：

(1) 本市集成电路设计企业。

(2) 集成电路设计企业首年度利用符合条件的生产线进行封装测试。

(3) 在关联企业进行封装测试的不计入补助核算费用总额。

2. 补助标准：

按封装测试费用的50%给予补助，每个单位年度补助总额不超过100万元。

3. 申报材料：

(1) 封装测试补助资金汇总表。

(2) 项目说明（包括产品概述、封装类型、测试方式）等，项目相关文档、图片。

(3) 项目订单或合同、发票、付款凭证、结算明细表等。

(十二) 支持公共服务平台提升服务能力

1. 申报条件:

(1) 本市集成电路产业公共服务平台。

(2) 公共服务平台每年度为50家以上企业提供技术研发支撑、流片代理、人才培养等服务。

2. 补助标准:

按服务收入的30%给予平台奖励, 每个平台年度奖励总额不超过100万元。

3. 申报材料:

(1) 公共服务平台补助资金汇总表。

(2) 服务合同、发票及银行收款凭证等。

(十三) 支持举办行业活动

1. 申报条件:

经报市集成电路办同意, 在本市组织举办全国性创新创业大赛、行业年会、产业大会、产业论坛等以推动产业发展为目的的非营利性活动。

2. 补助标准:

对活动场租费、交通费、资料费及专家差旅费、食宿费等支出的50%给予补助, 每场活动补助不超过100万元。

3. 申报材料:

(1) 专项审计报告。

(2) 发票及银行付款凭证等。

三、有关情况说明

（一）本实施细则中“符合条件”的企业（生产线）须为本市集成电路企业（生产线）。

（二）原集成电路政策中，涉及研发、生产、办公用房租金补助等政策，可申报由各区府、火炬管委会、自贸委组织实施的招商等相关政策中的现有补助政策；涉及企业增产增效奖励政策，可申报由市工信局组织实施的鼓励企业增产增效奖励政策（厦工信运行〔2022〕140号）；涉及重大科技奖励政策，可申报由市科技局组织实施的科学技术奖励办法（厦府办规〔2020〕7号）等。

（三）对于发生生产安全责任事故的，执行联合惩戒规定。